



各 位

2026 年 2 月 6 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 坂田 輝久
(コード番号 6855 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 執行役員 管理部門統括部長 石本 浩久
電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

新工場建設に関するお知らせ

当社は、2026 年 2 月 6 日開催の取締役会にて、新工場を建設することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 建設の目的

今後も拡大が見込まれるMタイププローブカード（MEMS技術を用いたプローブカード）の生産体制及び生産効率の強化、並びに次世代半導体向けプローブカードの開発推進により、顧客需要への対応力を向上させるため、兵庫県尼崎市において新工場を建設することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、Mタイププローブカードの生産において、既存の本社工場はプローブの生産、三田工場は配線基板の生産、熊本事業所はアッセンブリをそれぞれ担っているところ、当該新工場はMタイプ用プローブ等の開発・生産の強化を図るものです。

2. 建設計画の概要

(1) 名称	本社第2工場（仮称）
(2) 建設予定地	兵庫県尼崎市
(3) 投資内容	土地、建物及びプローブカードの製造・研究開発設備等
(4) 建設着工予定時期	2026 年 4 月
(5) 竣工予定時期	2028 年 8 月
(6) 建築面積	約 3,000 m ²
(7) 延床面積	約 8,000 m ²
(8) 投資予定額	約 125 億円
(9) 資金計画	自己資金及び借入金

3. 業績への影響

本件が 2026 年 3 月期における業績に与える影響はありません。今後開示すべき事項が生じた際には、速やかに開示いたします。

以上